2026 年 11 月 12 日

各　　位

会　社　名　株式会社ブイ・テクノロジー
代表者名　代表取締役 兼 社長執行役員　杉本　重人
（コード番号：7717、東証プライム市場）
会　社　名　株式会社 LE-TECHNOLOGY
代表者名　代表取締役社長　李　楫
問合せ先　ブイ・テクノロジー IR 室長 小野 雅弘
（TEL. 045-338-1981）

ＤＩ露光装置「ＬＡＭＢＤＩ」、海外パッケージメーカーより量産機を受注

株式会社ブイ・テクノロジー（以下「当社」）の連結子会社である株式会社 LE-TECHNOLOGY（以下「ＬＥＴ」）は、パッケージ基板向けＤＩ露光装置「ＬＡＭＢＤＩ（ラムディ）」の量産機について、海外パッケージメーカーより約 70 億円の受注を獲得いたしました。2026 年 3 月期第 4 四半期以降のサブストレート、インターポーザー向けＤＩ露光装置の累計受注額は約 160 億円に達しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．今回の受注について

半導体業界においては、生成ＡＩの普及に伴い高性能半導体の高集積化・大型化が進んでおり、これらを搭載するパッケージ基板には、配線の更なる微細化と基板の大型化への対応が求められています。マスクを用いずに回路パターンを基板へ直接描画するＤＩ（ダイレクトイメージング）露光装置は、こうした要求に対応できる露光方式として注目されております。

本件は、高性能半導体向けアドバンストパッケージ需要の拡大を背景としたもので、国内パッケージメーカーに続き、海外パッケージメーカーにも採用が広がったものです。ＬＡＭＢＤＩは、従来のＤＩ露光装置とは一線を画す多点リアルタイムオートフォーカス機能により、大型基板の全面にわたって高精度な微細パターンを形成することができます。当社グループがこれまで培ってきた大面積・高精度の露光技術に加え、こうした性能等が評価されたものと認識しております。

当社グループは、今後も半導体および電子デバイスの進化を支える革新的な技術の創出に取り組み、社会の発展に貢献してまいります。

２．受注内容

受注先	海外パッケージメーカー
受注製品	パッケージ基板向けＤＩ露光装置「ＬＡＭＢＤＩ」（量産機）
受注金額	約 70 億円
売上計上予定	2028 年 3 月期以降
量産機の累計受注額	約 160 億円（2026 年 3 月期第 4 四半期に国内パッケージメーカーより獲得した受注を含む）

３．業績への影響

当該受注は、2028 年 3 月期以降に売上計上する見込みです。

なお、当該受注による 2027 年 3 月期の連結業績への影響はありません。

以　上